



kingston.com/epop

ePoP

Memori Tertanam Package-on-Package untuk Perangkat yang Dapat Dikenakan

ePoP Kingston menyediakan komponen standar JEDEC yang terpadu yang menggabungkan penyimpanan Kartu Multimedia Tertanam (eMMC/Embedded MultiMedia Card) dan DRAM Laju Data Ganda Berdaya Rendah (LPDDR/Low-Power Double Data Rate) dalam solusi Package-on-Package (PoP). ePoP dipasang langsung di atas Sistem pada Chip (SoC/ System-on-a-Chip) host yang kompatibel sehingga mengurangi penggunaan ruang Papan Sirkuit Cetak (PCB/Printed Circuit Board) dan memastikan kinerja yang optimal. ePoP adalah solusi ideal untuk aplikasi dengan ruang terbatas, seperti perangkat yang dapat dikenakan (wearable).

MANFAAT UTAMA

- Dengan pemasangan langsung di atas SoC host, ePoP memberikan solusi ideal untuk aplikasi dengan faktor bentuk kecil, seperti perangkat yang dapat dikenakan.
- DRAM Daya Rendah dan firmware penyimpanan yang dioptimalkan mengurangi konsumsi daya sekaligus memberikan kinerja tinggi yang diperlukan untuk aplikasi perangkat dapat dikenakan yang bertenaga baterai.
- Menyederhanakan desain sistem, mempercepat waktu peluncuran ke pasar, dan memperpendek siklus kualifikasi.
- Berbagai konfigurasi firmware tersedia untuk menyesuaikan dengan persyaratan kinerja, daya, dan masa pakai aplikasi Anda.

SEGMENT PASAR



IoT



Perangkat yang Dapat Dikenakan



Perangkat Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)

NOMOR KOMPONEN DAN SPESIFIKASI EPOP

ePoP berbasis LPDDR4x

Nomor Komponen	Kapasitas		Deskripsi		Kemasan (mm)	FBGA	Suhu Pengoperasian
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
64EP16-M4MTB9W	64	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,6	144	-25°C ~ +85°C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,65	144	-25°C ~ +85°C

ePoP berbasis LPDDR5x

Nomor Komponen	Kapasitas		Deskripsi		Kemasan (mm)	FBGA	Suhu Pengoperasian
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
64EP16-M5ATB9W	64	16	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,58	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,65	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,7	201	-25°C ~ +85°C

